

Products Information

➤ 主な特長

- コネクタ挿抜時の摺動抵抗を低減します
従来のリフロー錫めっきと比較して、
動摩擦係数を最大30%程度低減できます
- Cu-Sn化合物の隙間に多くの錫を残存させており、
優れた電氣的接続信頼性を発揮します
- Cu-Mg系銅合金MSPシリーズをはじめ、
各種銅および銅合金との組み合わせが可能です

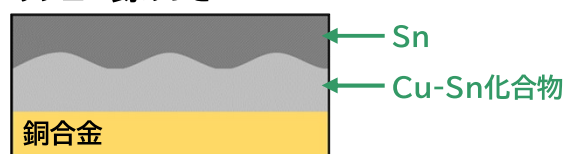
➤ 主な用途

- 車載用多極コネクタに用いられる小型端子

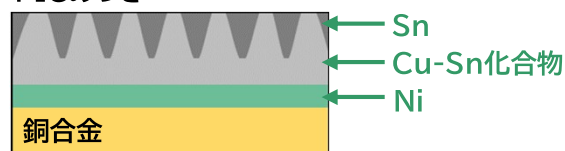
➤ めっきの構造

- Cu-Sn化合物を精密に制御し、柱状にすることで
表面に均一に露出させ、複相組織とすることにより、
動摩擦係数を低減しています

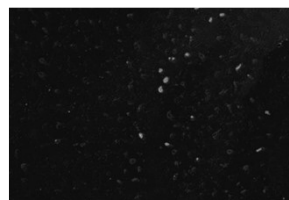
リフロー錫めっき



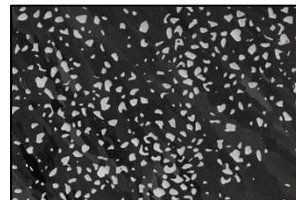
PICめっき®



リフロー錫めっき

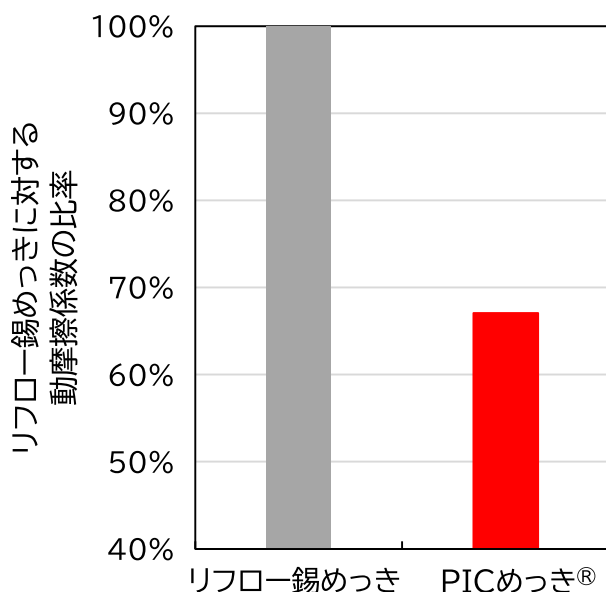


PICめっき®



白い部分がCu-Sn化合物

➤ 動摩擦係数



➤ 耐熱性

